PAT-NO:

JP02000251226A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000251226 A

TITLE:

SPIN VALVE MAGNETO-RESISTANCE SENSOR AND THIN-

FILM

MAGNETIC HEAD

PUBN-DATE:

September 14, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TANOGAMI, SHUJI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

READ RITE SMI KK

N/A

APPL-NO:

JP11055773

APPL-DATE:

March 3, 1999

INT-CL (IPC): G11B005/39

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the magneto-resistance sensor in spin valve

structure having an antiferromagnetic layer which produces an exchange coupling

magnetic field between a ferromagnetic material and a pin magnetic layer even

after a heat treatment, effectively suppresses the rotation of the magnetism of

the spin magnetic layer due to the bias magnetic field of a magnetic head, and

can obtain a high MR output.

SOLUTION: The spin valve magneto-resistance sensor has a magnetoresistance

effect film 3 formed by stacking on a substrate a ferromagnetic layer

pin magnetic layer 6 arranged across a nonmagnetic conductive layer 5 and an

antiferromagnetic layer 7 adjacent to the pin magnetic layer. In this case, 2

to 10 at% added to PtMn alloy, and 45 to 55 at% Mn and Pt for the rest are

added; and the antiferromagnetic layer is formed of the PtMcCr and thermally

treated at 250 to 300° C. In this case, the antiferromagnetic layer is

formed of PdPtMnCr alloy obtained by adding 2 to 10 at% Cr, 45 to 55 at% Mn, 20

to 35 at% Pd, and Pt for the rest to PdPtMn alloy and thermally treated at  $250\,$ 

to 300°C in a vacuum magnetic field.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

4/11/2006, EAST Version: 2.0.3.0

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-251226 (P2000-251226A)

(43)公開日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 5/39

G11B 5/39

5D034

# 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平11-55773

(22)出顧日

平成11年3月3日(1999.3.3)

(71)出願人 392034355

リードライト・エスエムアイ株式会社 大阪府三島郡島本町江川2丁目15番17号

(72)発明者 田ノ上 修二

兵庫県尼崎市扶桑町1番8号 住友金属工

業株式会社エレクトロニクス技術研究所内

(74)代理人 100098062

弁理士 梅田 明彦

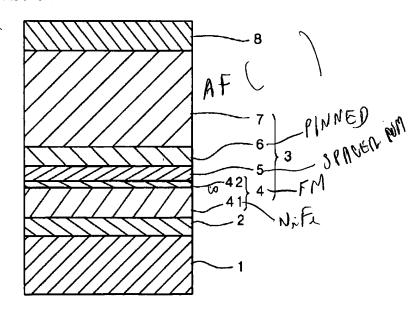
Fターム(参考) 5D034 BA05 CA08 DA07

# (54) 【発明の名称】 スピンパルプ磁気抵抗センサ及び轉膜磁気ヘッド

## (57)【要約】

【課題】 熱処理後に強磁性材料のピン磁性層との間で高い交換結合磁場を発揮し、磁気ヘッドのバイアス磁場によるピン磁性層の磁化の回転を有効に抑制し、高いMR出力が得られる反強磁性層を備えたスピンバルブ構造の磁気抵抗センサを提供する。

【解決手段】 基板上に非磁性導電層 5を挟んで配置されたフリー磁性層 4 及びピン磁性層 6と、ピン磁性層に隣接する反強磁性層 7 とを積層した磁気抵抗効果膜 3 を備えるスピンバルブ磁気抵抗センサにおいて、P d P t M n 合金にC r を 2 at %~1 0 at %の範囲で添加し、かつM n を 4 5~5 5 at %の範囲、P d を 2 0~3 5 at %の範囲、残部を P t とする P d P t M n C r 合金で反強磁性層を形成し、真空磁場中で 2 5 0 ℃~3 0 0 ℃の温度で熱処理を行う。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に非磁性導電層を挟んで配置され た1対の磁性層と、一方の前記磁性層に隣接する反強磁 性層とを積層した磁気抵抗膜を備えるスピンバルブ磁気 抵抗センサであって、

1

前記反強磁性層がPd-Pt-Mn-Cr合金からな り、かつその規則化のために熱処理されていることを特 徴とするスピンバルブ磁気抵抗センサ。

【請求項2】 前記反強磁性層の膜組成が、Mnを45 ~55at%, Cr&2~10at%, Pd&20~35at 10 %、残部をPtとすることを特徴とする請求項1に記載 のスピンバルブ磁気抵抗センサ。

【請求項3】 前記熱処理の温度が250℃乃至300 ℃の範囲であることを特徴とする請求項1又は2に記載 のスピンバルブ磁気抵抗センサ。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載 のスピンバルブ磁気抵抗センサを備えることを特徴とす る薄膜磁気ヘッド。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録装置に使 用される磁気抵抗型センサに関し、特にスピンバルブ磁 気抵抗効果を利用した磁気センサ及び薄膜磁気ヘッドに 関する。

# [0002]

【従来の技術】最近、再生用磁気ヘッドにおいて飽和磁 界を小さくして磁界感度を高めるために、基板上に非磁 性層を挟んで1対の磁性層を積層したサンドイッチ構造 のスピンバルブ膜からなる磁気抵抗(MR)センサが開 発されている。スピンバルブ膜は、一方の磁性層(ピン 磁性層)の磁化が、それに隣接する反強磁性層との交換 結合磁界により素子高さ方向に固定されるのに対し、他 方の磁性層(フリー磁性層)の磁化は、一般に永久磁石 の磁界を利用したハードバイアス法により、素子のトラ ック幅方向に単磁区化され、外部磁界により自由に回転

【0003】反強磁性層による一方向異方性磁場が大き いほど、ピン磁性層を良好に単磁区化することができ、 またその磁化が十分に固定されるほど、外部磁場に対す る磁気応答の線形性が確保され、磁気センサの磁気特性 40 が向上する。反強磁性材料としては、例えば特開平9-35212号公報に記載されるように、大きな交換結合 磁場が得られ、ブロッキング温度を高くでき、耐食性に 優れ、熱処理(アニール)温度が低いこと、及び膜厚を 薄くできることなどの特性が要求され、従来から様々な 材料が提案されている。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来か ら反強磁性材料として一般に使用されているFeMn合 金は腐食しやすいという問題がある。また、IrMn合 50 ピンバルブ膜の下地の検討」(日本応用磁気学会誌Vol.

金、RhMn合金、FeMn合金などは下地層の影響を 受け易いので、特に基板側に反強磁性層を配置しかつそ の上にピン磁性層を積層する所謂ボトムタイプのスピン バルブ構造では、(111)結晶配向性の高い下地膜を 設けたり、膜厚を厚くする必要がある。また、NiMn 合金では、ピン磁性層との交換結合を十分に確保するた めに、250℃以上の高温で熱処理(アニール)する必 要がある。しかし、NiMn合金は、後述するPtMn 合金、PdMn合金に比してMnが拡散し易いために、 ピン層/非磁性層/フリー層間に金属元素の拡散が生じ てMR比を低下させる虞がある。

【0005】かかる問題を解消するために、例えば特開 平9-147325号公報では、Ptが5~54at%、 Mnが46~95at%のPtMn合金を用いて反強磁性 層を形成し、かつ200℃~350℃の温度で熱処理し た磁気抵抗効果型読取りヘッドが提案されている。更 に、特開平10-91921号公報には、好ましくはP tが44~51at%、Mnが49~56at%のPtMn 合金、又はこれと同等の性質のPt-Mn-X合金(X =Ni, Pd, Rh, Ru, Ir, Cr, Fe, C o)、PdMn合金を用いて反強磁性層を形成したデュ アルスピンバルブ型薄膜磁気ヘッドが開示されている。 両公報によれば、PtMn合金は耐食性が良好で、交換 異方性磁界が大きくかつ熱的に安定し、ピン磁性層の上 下いずれに積層しても有効な交換異方性磁界を発揮する ことができ、ブロッキング温度が高く、磁気抵抗効果の 線形応答性及び熱的安定性に優れた良好な薄膜磁気へッ ドが得られる。

【0006】また、特開平9-16923号公報には、 スピンバルブセンサ層の両端部に隣接接合して形成した 磁区制御層を、Ta膜、強磁性NiFe膜及び反強磁性 CrMnPt膜の積層構造により構成したスピンバルブ センサが記載されている。同公報によれば、この反強磁 性膜は、その組成がCr30~70at%、Mn30~7 Oat%、Pt3.0~30.0at%であって、Cr含有 量が多いことにより、耐食性が著しく向上すると共に、 Ptの添加により、その下層に形成されるNiFe強磁 性膜との良好な交換結合特性を示し、かつブロッキング 温度が高い。

【0007】特開平9-81915号公報には、PtM n合金より更に耐食性の高いPdPtMn合金を用いて 反強磁性層を形成し、かつ約230℃の比較的低い温度 で熱処理することにより、磁気抵抗特性を劣化させるこ となく反強磁性を付与することができ、それにより信頼 性を向上させたスピンバルブ構造の磁気抵抗素子が記載 されている。同公報によれば、PdPtMn合金は、M nの原子分率が48~54at%のときに特に高いバイア ス磁界量が得られる。

【0008】また、青島賢一らの論文「PdPtMnス

4

22、No.4-2, 1998、第501~504頁)には、PdPtMn合金の反強磁性層を基板側に配置したスピンバルブ膜において、その下地材料にNiFeCrを用いた場合に、PdPtMn反強磁性層の(111)結晶配向性が向上することにより、交換結合磁界が増加し、MR比が向上したことが報告されている。

3

【0009】しかしながら、上述したPdPtMn系合金では、耐食性は改善されるが、規則化のための熱処理後の一方向異方性磁場が十分に大きくないために、磁気ヘッド内部のバイアス磁場などの作用で異方性の方向が10回転する慮がある。そのために、スピンバルブセンサのMR出力が徐々に低下し、高い再生出力を維持できなくなり、磁気ヘッドの信頼性を損なうという問題があった。

【0010】そこで、本発明の目的は、上述した従来の問題点に鑑み、熱処理後も強磁性材料のピン磁性層との間で高い交換結合磁場を発揮し、磁気ヘッドのバイアス磁場によるピン磁性層の磁化の回転を有効に抑制し、高いMR出力が得られる反強磁性層を備えたスピンバルブ構造の磁気抵抗センサを提供することにある。

【0011】また、本発明の別の目的は、かかるスピンバルブ磁気抵抗センサを備えることにより、優れた磁気特性及び高い信頼性を有し、より高記録密度化を達成可能な高性能の薄膜磁気ヘッドを提供することにある。

# [0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した目的を達成するためのものであり、基板上に非磁性導電層を挟んで配置された1対の磁性層と、一方の前記磁性層に隣接する反強磁性層とを積層した磁気抵抗膜を備えるスピンバルブ磁気抵抗センサであって、前記反強磁性層が 30 PdーPtーMnーCr合金からなり、かつその規則化\*

\*のために熱処理されていることを特徴とするスピンバル ブ磁気抵抗センサが提供される。

【0013】本願発明者は、このようにPdPtMn合金にCrを適量添加しかつ熱処理して結晶構造を規則化することにより、交換結合磁場Hexを増大させることが可能であり、それにより高温の磁場中でもピン磁性層の磁化の回転が小さく、従ってMR出力が低下しないことを見い出して、本発明に至ったものである。PdPtMn合金に添加する金属XとしてCrを選定するに当たり、Zr、Nb、Ti、Cr、Ta、Mo、W、V、Alを候補として、ガラス基板のTa100Å/CoFe100Åからなる下地膜上にPdPtMnXを成膜し、これらを真空磁場中で熱処理した後、磁気特性を評価した。その結果、Cr以外の元素を添加したものは交換結合磁場Hexが低下したのに対し、Crを添加した場合にのみ交換結合磁場Hexが増加することが分かった。

【0014】次に、反強磁性層としてPdPtMnCr合金のCr添加量を決定するに当たり、まず、ガラス基板上にTa30Å/NiFe100Åを成膜し、その上にPdPtMnCrを、Pd30Pt20Mn50ターゲット上にCrチップを載せてスパッタリングにより膜厚350Åに成膜し、更にその上に保護膜としてTaを30Å成膜した。これを真空度1×10-6Torr以下の加熱炉で、1k0eの磁場中で280℃×10時間の熱処理を行い、交換結合磁場Hexを評価した。Cr含有量は、同様にスパッタリングの際にターゲット上に載せるCrチップの数により調整し、実際のCr含有量はICP分析により求めた。Cr含有量に関する格子定数(a、c)及び交換結合磁場Hexの変化を表1に示す。

【0015】

【表1】

Cr量(at%)	格子定数(Å)	Неж(Ое)
0	a=4.05 c≃3.61	47
1	a=4.04 c=3.60	55
2	a=4.03 c=3.55	112
5	a=4.03 c=3.57	150
8	a=4.02 c=3.59	140
10	a=4.02 c=3.59	120
12	-	72

【0016】この表から、Cr含有量が2at%以上で交※50※換結合磁場Hexが増大し、10at%を超えると低下して

5

いることが分かる。この理由として、C rの添加により PdPtMn合金中のPt及びPd原子がより小さい原子半径のC rと置き換わり、格子定数が小さくなってM n原子間の距離が短くなり、反強磁性結合が強まったためと考えられる。また、C r含有量が10at%を超えると、PdPtMn合金中のMnのサイトにもC r原子が入るため、交換結合磁場Hexが低下したと考えられる。この結果、反強磁性層としてのPdPtMnC r合金のC r含有量は、2~10at%の範囲が最適である。更にPdPtMn系合金では、Pd含有量は20~35at% 10の範囲で交換結合磁場Hexが大きくなるので、この範囲が望ましい。

【0017】また、熱処理温度は250℃乃至300℃の範囲が望ましい。十分な規則化のためには、少なくとも250℃の温度で熱処理する必要があるが、300℃を越えると、反強磁性層と隣接する強磁性層との間及び/又は非磁性導電層を挟んだ強磁性層間での拡散が大きくなり、MR特性の劣化やピン磁性層/フリー磁性層間の相互作用が大きくなるので、好ましくない。

【0018】更に本発明の別の側面によれば、上述した 20 スピンバルブ磁気抵抗センサを備えることにより、磁気 抵抗変化率及びその線形応答性が優れ、高記録密度化可 能な薄膜磁気ヘッドが提供される。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の好適な実施の形態について添付の図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明を適用したスピンバルブ構造の磁気抵抗センサをABS(空気ベアリング面)側から見た断面図を示している。このスピンバルブ磁気抵抗センサは、ガラスやシリコン、Al2O3・TiCなどのセラミック材料か 30らなる基板上に設けたアルミナ(Al2O3)絶縁層1の上に厚さ30ÅのTaからなる下地層2が形成され、その上に基板とは反対側に反強磁性層を配置した所謂トップスピンバルブ構造の磁気抵抗(MR)膜3が積層されている。

【0020】MR膜3は、下地層2の上に積層したNi Fe膜41及びCo膜42からなるフリー磁性層4と、 Cu膜からなる非磁性導電層5と、Co膜からなるピン 磁性層6と、PdPtMnCr膜からなる反強磁性層7 とを有する。MR膜3は、成膜後に真空中で250℃~ 40 300℃の温度で一方向磁場中熱処理を行うことにより、反強磁性層7の結晶構造を規則化させ、かつピン磁性層6に一方向異方性を与えて、その磁化配向を固定する。MR膜3の上には、Taからなる保護膜8が成膜されている。前記各膜層は、例えばDCスパッタリングにより連続的に成膜される。

【0021】MR膜3の両側は、所定のトラック幅に合わせてエッチングにより除去され、ハードバイアス層及びセンス電流を流すための電極としての導電リード(共に図示せず)等が形成される。更に、この積層構造全体をアルミナ絶縁層で被覆して、本発明のスピンバルブMRセンサが完成する。

【0022】反強磁性層7の組成は、Pdが20at%~35at%、Mnが45at%~55at%、Crが2at%~10at%の範囲であり、残部がPtである。この膜組成により、前記反強磁性層は熱処理後にピン磁性層との間で高い交換結合磁場が得られる。

【0023】本発明は、図1に関連して上述したトップスピンバルブ構造だけでなく、反強磁性層を基板側に配置した所謂ボトムスピンバルブ構造、2組のピン磁性層と反強磁性層とをフリー磁性層を挟んで対称に配置するデュアルスピンバルブ構造、ピン磁性層が非磁性膜を挟んで反強磁性的に結合する1対の強磁性膜から構成され、印加磁界の存在下で反強磁性層とそれに隣接する一方の強磁性膜とが交換結合するシンセティック(synthetic)タイプのスピンバルブ構造など、公知の様々な構造のスピンバルブMRセンサに同様に適用することができる。

### [0024]

【実施例】(実施例1)図1のMRセンサにおいて、ガラス基板の上にTa30Å/NiFe50Å/Co10 Å/Cu25Å/Co30Å/PdPtMnCr300 Å/Ta30Åのスピンバルブ膜をDCスパッタリングにより連続して成膜し、30000eの真空磁場中で250℃×10時間熱処理を施した。PdPtMnCr反強磁性層7の組成を変化させ、その各々についてMR曲線を測定した。その結果を表2に示す。

[0025]

【表2】

,					
Pt(a1%)	Pd(at%)	Cr(at%)	Mn(at%)	MR(%)	Hex(Oe)
22	28	0	· 50	7.0	680
22	25	5	48	7.6	1200
15	35	8	42	5.2	750
14	30	4	52	7.6	1000
20	24	1	55	7.2	720
18	32	5	45	7.7	1100
18	25	12	45	6.8	760
22	20	8	50	7.5	1150
18	18	9	55	6.8	790

【0026】この表から、Pdが20at%~35at%、 20\*r反強磁性層7の組成をPd23Pt22Mn50Cr5及び Mnが45at%~55at%、Crが2at%~10at%の 範囲において交換結合磁場Hexが顕著に大きく、かつM R比が著しく高くなっていることが分かる。

【0027】(実施例2)同じく図1のMRセンサにお いて、熱酸化Si基板の上にTa30A/NiFe60 Å/Co10Å/Cu25Å/Co30Å/PdPtM nCr250Å/Ta30Åのスピンバルブ膜をDCス パッタリングにより連続して成膜した。PdPtMnC\*

Pd24Pt22.5Mn52Cr1.5の2種類とし、かつ30 000eの真空磁場中で5時間熱処理した。熱処理温度 は230℃から250℃、270℃、300℃、320 ℃までの5段階に変化させた。その各々について熱処理 後にMR曲線を測定し、交換結合磁場Hex及びMR比の 変化を調べた。その結果を表3に示す。

[0028]

【表3】

熱処理温度(℃)	粗成(at%)	Hex(Oe)	MR比(%)
230	Pd23Pt22Mn50Cr5	800	6.5
250	Pd23Pt22Mn50Cr5	1220	7.6
270	Pd23Pt22Mn50Cr5	1270	7.6
300	Pd23P122Mn50Cr5	1350	7.1
320	Pd23Pt22Mn50Cr5	1390	5.0
230	Pd24Pt22.5Mn52Cr1.5	750	6.4
250	Pd24Pt22.5Mn52Cr1.5	780	7.1
270	Pd24Pt22.5Mn52Cr1.5	820	7.1
300	Pd24Pt22.5Mn52Cr1.5	840	6.7
320	Pd24Pt22.5Ma52Cr1.5	850	4.8

【0029】この表から、Cr含有量が本発明の範囲内 ※較して、熱処理温度によらず交換結合磁場Hexが顕著に にある5at%では、Cr含有量が1.5at%のものに比※50 大きく、かつMR比が著しく高いことが分かる。また、

熱処理温度を本発明の範囲(250℃、270℃、30 O℃)とした場合には、交換結合磁場Hex及びMR比が 高い。これに比較して熱処理温度を230℃としたもの は、交換結合磁場Hex及びMR比共に小さい。また、3 20℃の熱処理温度では、交換結合磁場Hexは大きいが MR比が低い。このように、熱処理温度は250℃~3 00℃の範囲が適正である。

# [0030]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 のスピンバルブ磁気抵抗センサによれば、PdPtMn 10 2 下地層 合金にCrを2at%~1 Oat%の範囲で添加し、Pdを 20at%~35at%、Mnを45at%~55at%の範 囲、残部をPtとしたPdPtMnCr合金で反強磁性 層を形成しかつ熱処理を行うことにより、熱処理後に従 来より大きい交換結合磁場Hexが得られ、それにより磁 気ヘッドのバイアス磁場によってもピン磁性層の磁化が 回転せず、MR出力の低下が抑制されて、再生出力の向 上、その熱的・磁気的安定性が達成される。更に、本発

明によれば、高い磁気抵抗変化率及び線形応答性など、 磁気変換特性を向上させたスピンバルブ磁気抵抗センサ が得られることにより、高記録密度化可能で高性能かつ 高信頼性の磁気ヘッドを実現することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用したスピンバルブ磁気抵抗センサ の要部をABS側から見た模式的断面図。

## 【符号の説明】

- 1 絶縁層
- - 3 MR膜
  - 4 フリー磁性層
  - 41 NiFe膜
  - 42 Co膜
  - 5 非磁性導電層
  - 6 ピン磁性層
  - 7 反強磁性層
  - 8 保護層

### 【図1】

